

## LISA ULTRA-LOW POWER IC FOR SECURE RF APPLICATIONS

### > OBJECTIF DU PROJET

Le marché du sans contact / dual interface est en pleine croissance dans les trois principaux domaines que sont le transport, l'identité et le bancaire. L'ergonomie, le facteur de forme et la performance des solutions employées restent des enjeux déterminants quant à l'acceptation par les usagers des offres déployées, et en dehors du domaine des télécommunications, le problème reste entier pour les autres secteurs qui sont des marchés importants et établis, et se posera de façon encore plus aigüe (facteur de forme) sur les marchés émergents des objets intelligents.



Partant de ce constat, StarChip et SPS ont élaboré un brevet commun avec un concept permettant d'améliorer les performances des cartes dual interface. Ainsi, le projet LISA propose de finaliser ce processus et de développer des objets sans contact, basés sur un nouveau module RF. Son objectif majeur est de diminuer le besoin énergétique des solutions actuelles à performances égales. Ce module RF pourra être intégré dans une carte à puce afin d'adresser tous les marchés établis (Bancaire, Identité, Transport) ou sous d'autres types de format.

### > PORTEUR DU PROJET



### > PARTENAIRES



### > FINANCEMENT

- Année de sélection : 2014
- Appel à projets : FUI 17
- Financeurs :



- Durée du projet : 42 mois
- Budget : 6.4M€

### > RETOMBÉES ATTENDUES

- Création de 30 emplois
- Plus de 250M€ de chiffre d'affaires

